# TPD-TR4A评审表（单板工艺）

平台（技术）名称/版本： □ 本分项免评审 N/A

| **项目** | **评审要素** | **检查结果** | | | **检查结果说明** | **评审操作指导** | **类别** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单板工艺** | 1 单板/背板的 工装夹具是否提供？ | □  是 | □  否 | □  免 | *记录发现的与该评审要素有关的的问题、风险以及问题的改进建议、风险分析等。以下同此。* | 对于单板、背板：  初始产品生产前需提供以下工装夹具：  钢网、SMT夹具、单板元器件安装夹具、周转工具、成型夹具、压接模具、预装夹具、检修夹具、插件夹具、波峰焊夹具、老化夹具等其中必须使用的夹具须提供  以下夹具可在TR6前提供：  ICT夹具、补焊夹具 | A | 关联：  Sub-TR：制造系统验证方案  交付件：NA  活动：NA |
| 2 安规实验中单板工艺问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参考"规格分项"相应要素的评审操作指导  主要内容：  （1）器件引脚、螺钉禁布区满足安全要求  （2）PCB的阻燃  判定依据：  1）如试验未开展，认为此项不合格  2）TR4A是基于原型机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在原型机上整改能通过测试，并且对于整改措施，专业实验室工程师与产品线沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。判定的依据为专业实验室的实验报告。如试验中不合格项主要与工艺有关，则 认为此项不合格； | B | 关联：  Sub-TR：SDV测试报告  交付件：NA  活动：NA |
| 3 EMC实验中单板工艺问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参考"规格分项"相应要素的评审操作指导 | B | 关联：  Sub-TR：SDV测试报告  交付件：NA  活动：NA |
| 4 环境实验中单板工艺问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参考"规格分项"相应要素的评审操作指导  主要内容：  单板结构件装配的可靠性：扣板、散热器、扩展板等掉落、损坏 | B | 关联：  Sub-TR：SDV测试报告  交付件：NA  活动：NA |
| 5 热测试中单板工艺问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参考"规格分项"相应要素的评审操作指导 | B | 关联：  Sub-TR：SDV测试报告  交付件：NA  活动：NA |
| 6 防护测试中单板工艺问题是否已经解决？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 参考"规格分项"相应要素的评审操作指导 | B | 关联：  Sub-TR：SDV测试报告  交付件：NA  活动：NA |
| 7 工艺难点问题是否经过验证？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 工艺总体方案中的工艺难点要求经过验证 | A |  |
| 8 对于采用环保设计或无铅工艺的产品，单板组装工艺遗留问题是否有解决方案？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求有解决方案 | A | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：CMM缺陷跟踪电子流 |
| 9 其他工艺遗留问题是否有解决方案？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求有解决方案 | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：CMM缺陷跟踪电子流 |
| 10 单板加工中使用和产生的非环保物质是否有合理的防范、处理措施？ | □  是 | □  否 | □  免 |  | 要求有防范方案和处理措施  参加公司相关技术规范 | B | 关联：  Sub-TR：NA  交付件：NA  活动：CMM缺陷跟踪电子流 |
| **评 审要素设置说明** | 在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。  对于 要素表中没有满足的项目，要记录存在的问题，给出改进计划，组织对问题和改进计划的评审，并进行风险评估，给出规避措施。所有这些均应体现在TR评审报告中。 | | | | | | | |
| **签名** | 检查人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |